

B008 Disclosure 信息披露

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2026-006
深圳市大为创新科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十六次会议、2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为控股子公司提供担保额度、子公司之间互相提供担保额度总计不超过180,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过120,000万元。在上述额度范围内,公司及控股子公司因业务需要办理互担担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等,担保种类包括保证、抵押、质押等,担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为2024年度股东大会审议通过后至2025年度股东大会重新审议为止。公司融资业务提供担保额度之前。

详情参见公司于2025年4月25日、2025年5月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》《2024年度股东大会决议公告》及相关公告。

二、担保进展情况

(一) 近日,公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行(以下简称“中国银行罗湖支行”)签订了《保证合同》(编号:2026圳中银保字第000037号),为公司全资子公司深圳市大为创新电子有限公司(以下简称“大为芯创”)在中国银行罗湖支行人民币1,000万元的《流动资金借款合同》提供连带责任保证。

(二) 近日,公司与中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行(以下简称“工商银行新沙支行”)签订了《最高额保证合同》(编号:04000001-2026年新沙(保)字0093号),为公司全资子公司大为创新电子有限公司深圳新沙支行人民币1,000万元的《小企业借款合同》提供最高额连带责任保证。

(三) 近日,公司与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)签订了《最高额保证合同》(编号:6209293-001),为公司全资孙公司深圳市芯汇群科技股份有限公司(以下简称“芯汇群”)在北京银行深圳分行人民币1,000万元的综合授信额度提供最高额连带责任保证。

上述担保事项在公司第六届董事会第二十六次会议、2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一) 深圳市大为创新电子有限公司

1、名称:深圳市大为创新电子有限公司
2、成立日期:2011年3月23日
3、注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406
4、法定代表人:连浩臻
5、注册资本:3,000万元人民币

6、经营范围:一般经营项目:半导体电子产品测试,晶圆测试,半导体电子产品的生产及销售;深港福环批#2013400019号批生产);集成电路、混合集成电路、新型电子器件、电子元件及软件的技术开发;国内贸易、法律法规、国务院决定规定的项目登记前须批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无。

7、股权结构:公司持有大为芯创100%股权

8、与公司关系:大为芯创为公司全资子公司

9、主要财务指标:

单位:人民币元

项目名称	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	15,809,706.13	64,947,883.30
负债总额	10,278,043.03	61,704,510.66
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	5,531,663.10	3,243,327.64
项目名称	2025年1-9月 (未经审计)	2024年1-12月 (经审计)
营业收入	291,064,432.08	407,738,212.43
利润总额	2,408,667.03	1,705,176.96
净利润	2,288,335.46	1,673,377.04

10、大为芯群不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 公司与中国银行罗湖支行签订的《保证合同》主要内容

1、保证人:深圳市大为创新科技股份有限公司
2、债权人:中国银行股份有限公司深圳罗湖支行
3、债务人:深圳市大为创新电子有限公司
4、保证方式:连带责任保证
5、主债权:主合同项下发生的债权构成合同之主债权,包括本金、利息(包括利、复利、罚息)、违约金、赔偿金,实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

6、保证期间:本合同保证期间为自债权的诉讼时效期间届满之日起三年,如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日起三年。

(二) 公司与工商银行新沙支行签订的《最高额保证合同》主要内容

1、保证人:深圳市大为创新科技股份有限公司
2、债权人:中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行
3、债务人:深圳市大为创新电子有限公司
4、保证方式:连带责任保证
5、主债权:公司所担保的主债权自2026年02月02日至2027年02月02日期间(包括该期间的起始日和届满日),在人民币100000000.00元(大写:人民币壹仟万元整)(大小写不一致的,以大写为准)的最高余额内,债权人依据与债务人签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立保函协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等形成的债权,贵金属(黄金、白银、铂金等贵金属品种,下同)租赁费以及因其他文件(下称主合同)而享有的对债务人的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。上条所述最高余额,是指在公司承担保证责任的主债权确定之日起,人民币表示的债权本金余额之和。

6、保证期间:自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之日起三年;债权人根据主合同之约定宣布借款期限或贵金属租赁期限提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租赁期限提前到期之日起三年。

(三) 公司与北京银行深圳分行签订的《最高额保证合同》主要内容

1、保证人:深圳市大为创新科技股份有限公司
2、债权人:北京银行股份有限公司深圳分行
3、债务人:深圳市芯汇群科技有限公司
4、保证方式:连带责任保证
5、主债权:主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司及其他分支机构)的全部债权,包括主债权本金及最高限额人民币金额大写壹仟万元整以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼费/仲裁费、评估/鉴定/拍卖费/差旅费、律师费、调查取证费、公证费及其他合理费用)及其他款项,合计最高债权额为人民币金额大写贰仟万元整。因主合同之约定解除宣布借款或贵金属租赁提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期之日起三年。

6、保证期间:自主合同下被担保债务的履行期限届满(含约定定期限届满以及依照约定或法律规定履行期限届满,下同)之日起三年。如果担保债务应当分期履行,则北京银行既有权在每期债务的履行期限届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任,也有权在主合同下该期之后任何一期债务履行期限届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任,并有权在该期间债务逾期而依照主合同的或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

(四) 大为芯创为公司全资子公司,芯汇群为公司全资孙公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,扣除已履行到期的担保,公司为子公司提供担保的累计担保总额为7,210万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.76%;公司及子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形;公司及子公司不存在逾期担保、也不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

(一) 公司与中国银行罗湖支行签订的《保证合同》;
(二) 公司与工商银行新沙支行签订的《最高额保证合同》;
(三) 公司与北京银行深圳分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司
董 事 会
2026年2月5日

10、大为芯创不属于失信被执行人。

(二) 深圳市芯汇群科技有限公司

1、名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2、成立日期:2021年5月11日
3、注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406
4、法定代表人:连浩臻
5、注册资本:100万人民币

6、经营范围:一般经营项目:半导体电子产品测试,晶圆测试,半导体电子产品的生产及销售;深港福环批#2013400019号批生产);集成电路、混合集成电路、新型电子器件、电子元件及软件的技术开发;国内贸易、法律法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无。

7、股权结构:公司持有大为芯创100%股权

8、与公司关系:芯汇群为公司全资子公司

9、主要财务指标:

单位:人民币元

10、大为芯创不属于失信被执行人。

(二) 深圳市芯汇群科技有限公司

1、名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2、成立日期:2021年5月11日
3、注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406
4、法定代表人:连浩臻
5、注册资本:3,000万元人民币

6、经营范围:一般经营项目:半导体电子产品测试,晶圆测试,半导体电子产品的生产及销售;深港福环批#2013400019号批生产);集成电路、混合集成电路、新型电子器件、电子元件及软件的技术开发;国内贸易、法律法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无。

7、股权结构:公司持有大为芯创100%股权

8、与公司关系:芯汇群为公司全资子公司

9、主要财务指标:

单位:人民币元

10、大为芯创不属于失信被执行人。

(二) 深圳市芯汇群科技有限公司

1、名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2、成立日期:2021年5月11日
3、注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406
4、法定代表人:连浩臻
5、注册资本:3,000万元人民币

6、经营范围:一般经营项目:半导体电子产品测试,晶圆测试,半导体电子产品的生产及销售;深港福环批#2013400019号批生产);集成电路、混合集成电路、新型电子器件、电子元件及软件的技术开发;国内贸易、法律法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无。

7、股权结构:公司持有大为芯创100%股权

8、与公司关系:芯汇群为公司全资子公司

9、主要财务指标:

单位:人民币元

10、大为芯创不属于失信被执行人。

(二) 深圳市芯汇群科技有限公司

1、名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2、成立日期:2021年5月11日
3、注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406
4、法定代表人:连浩臻
5、注册资本:3,000万元人民币

6、经营范围:一般经营项目:半导体电子产品测试,晶圆测试,半导体电子产品的生产及销售;深港福环批#2013400019号批生产);集成电路、混合集成电路、新型电子器件、电子元件及软件的技术开发;国内贸易、法律法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无。

7、股权结构:公司持有大为芯创100%股权

8、与公司关系:芯汇群为公司全资子公司

9、主要财务指标:

单位:人民币元

10、大为芯创不属于失信被执行人。

(二) 深圳市芯汇群科技有限公司

1、名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2、成立日期:2021年5月11日
3、注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406
4、法定代表人:连浩臻
5、注册资本:3,000万元人民币

6、经营范围:一般经营项目:半导体电子产品测试,晶圆测试,半导体电子产品的生产及销售;深港福环批#2013400019号批生产);集成电路、混合集成电路、新型电子器件、电子元件及软件的技术开发;国内贸易、法律法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无。

7、股权结构:公司持有大为芯创100%股权

8、与公司关系:芯汇群为公司全资子公司

9、主要财务指标:

单位:人民币元

10、大为芯创不属于失信被执行人。

(二) 深圳市芯汇群科技有限公司

1、名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2、成立日期:2021年5月11日
3、注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406
4、法定代表人:连浩臻
5、注册资本:3,000万元人民币

6、经营范围:一般经营项目:半导体电子产品测试,晶圆测试,半导体电子产品的生产及销售;深港福环批#2013400019号批生产);集成电路、混合集成电路、新型电子器件、电子元件及软件的技术开发;国内贸易、法律法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无。

7、股权结构:公司持有大为芯创100%股权

8、与公司关系:芯汇群为公司全资子公司

9、主要财务指标:

单位:人民币元

10、大为芯创不属于失信被执行人。

(二) 深圳市芯汇群科技有限公司

1、名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2、成立日期:2021年5月11日
3、注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406
4、法定代表人:连浩臻
5、注册资本:3,000万元人民币

6、经营范围:一般经营项目:半导体电子产品测试,晶圆测试,半导体电子产品的生产及销售;深港福环批#2013400019号批生产);集成电路、混合集成电路、新型电子器件、电子元件及软件的技术开发;国内贸易、法律法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无。

7、股权结构:公司持有大为芯创100%股权

8、与公司关系:芯汇群为公司全资子公司

9、主要财务指标:

单位:人民币元

10、大为芯创不属于失信被执行人。

(二) 深圳市芯汇群科技有限公司

1、名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2、成立日期:2021年5月11日
3、注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406
4、法定代表人:连浩臻
5、注册资本:3,000万元人民币

6、经营范围:一般经营项目:半导体电子产品测试,晶圆测试,半导体电子产品的生产及销售;深港福环批#2013400019号批生产);集成电路、混合集成电路、新型电子器件、电子元件及软件的技术开发;国内贸易、法律法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无。